



2025年3月期  
(2024年4月1日 ~ 2025年3月31日)

# 決算説明資料

2025年5月28日

**ENOMOTO Co.,Ltd.**

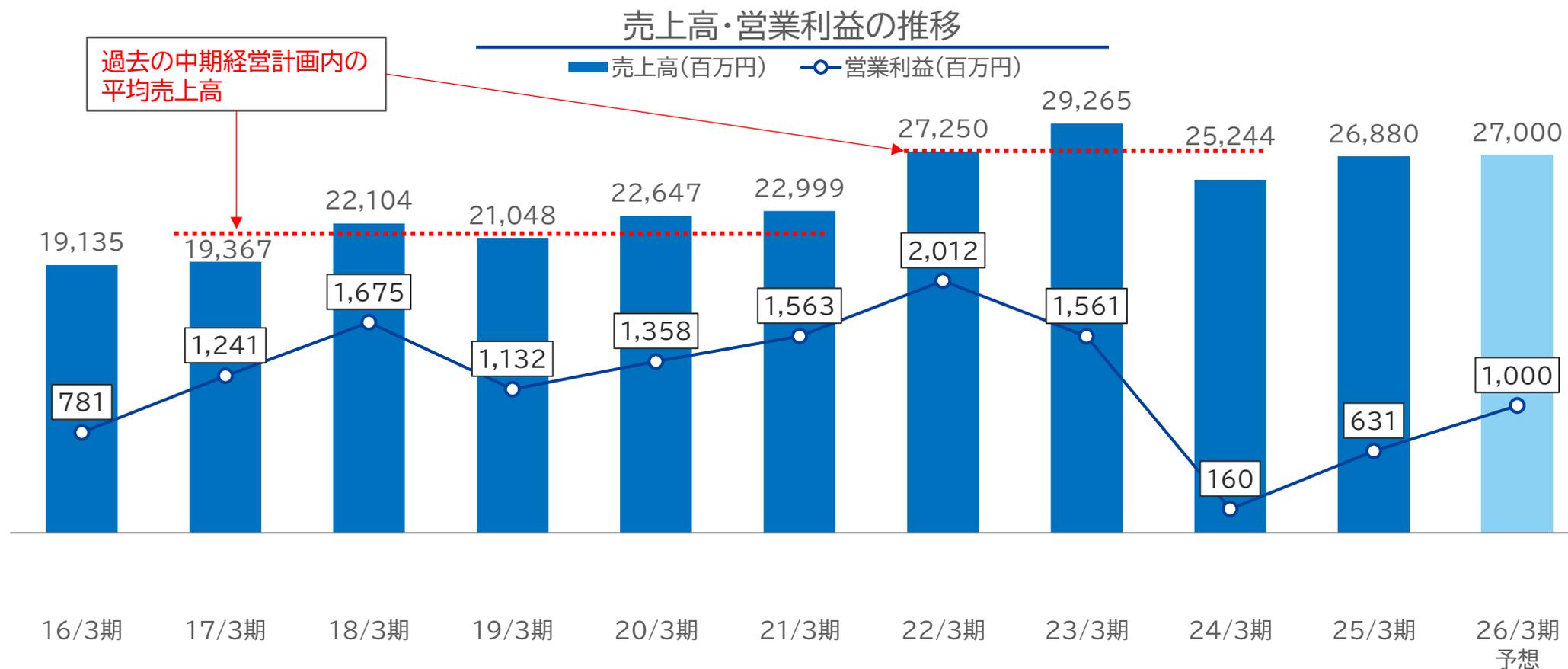
東証プライム 証券コード:6928

(1) 業績概要	P. 3
(2) 当社製品と強み	P. 6
(3) 2025年3月期決算	P. 16
(4) 2026年3月期業績予想	P.23
(5) 中期経営計画の進捗	P.28
(6) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて	P.44
Appendix	P.47

# (1)業績概要



- 2021年3月期までの5年間は、マイクロコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- ビジョン2030 1st STEPでは、22年3月期に過去最高益を計上したものの、23年3月期4Qからはスマートフォンを中心として民生・産機向けが調整。津軽工場新棟など先行投資に伴う償却費の増加もあり24年3月期は大幅減益
- 25年3月期は増益に転じたが利益水準が低い。26年3月期は高付加価値製品の増加による増益を予想



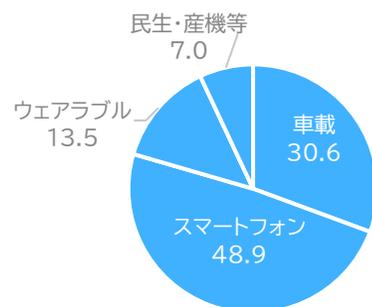
- パワー半導体用リードフレームは民生・産機向けの汎用リードフレームの調整が長期化
- オプト用リードフレームはハイエンド品の民生向けが先行して増加し、車載向けは26年3月期より量産本格化
- コネクタ用部品は車載向けは前期並み、ウェアラブル向けも調整局面を脱した

## その他

売上高 **651**百万円  
 前同比 **+31.6%**  
 構成比 **2.4%**

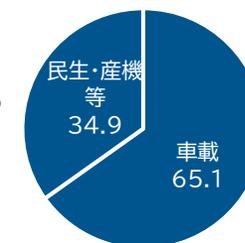
## コネクタ用部品

売上高 **12,085**百万円  
 前同比 **+10.0%**  
 構成比 **45.0%**



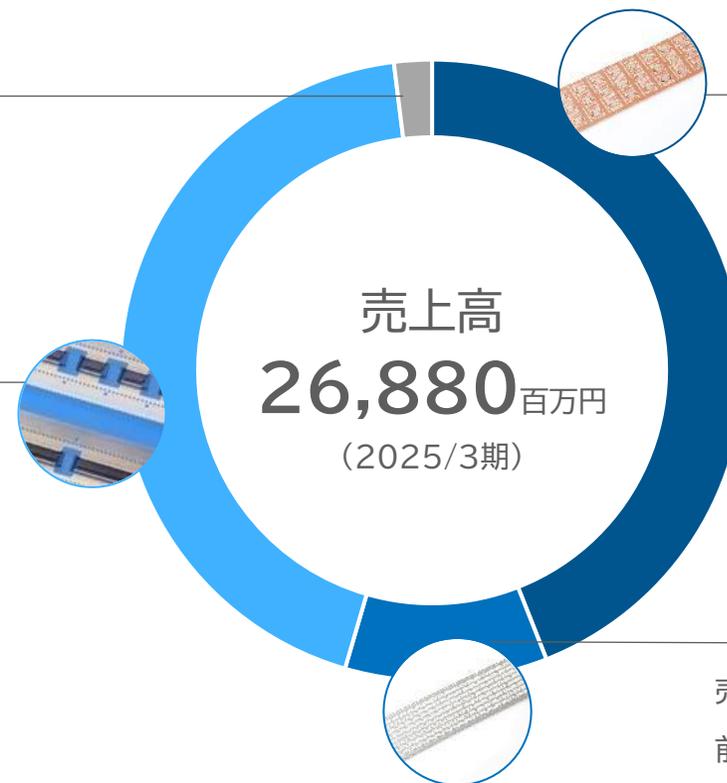
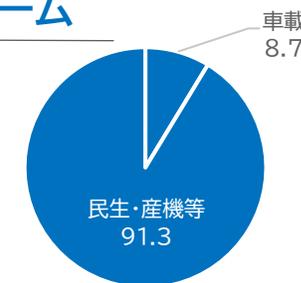
## パワー半導体用リードフレーム

売上高 **10,771**百万円  
 前同比 **△3.1%**  
 構成比 **40.1%**



## オプト用リードフレーム

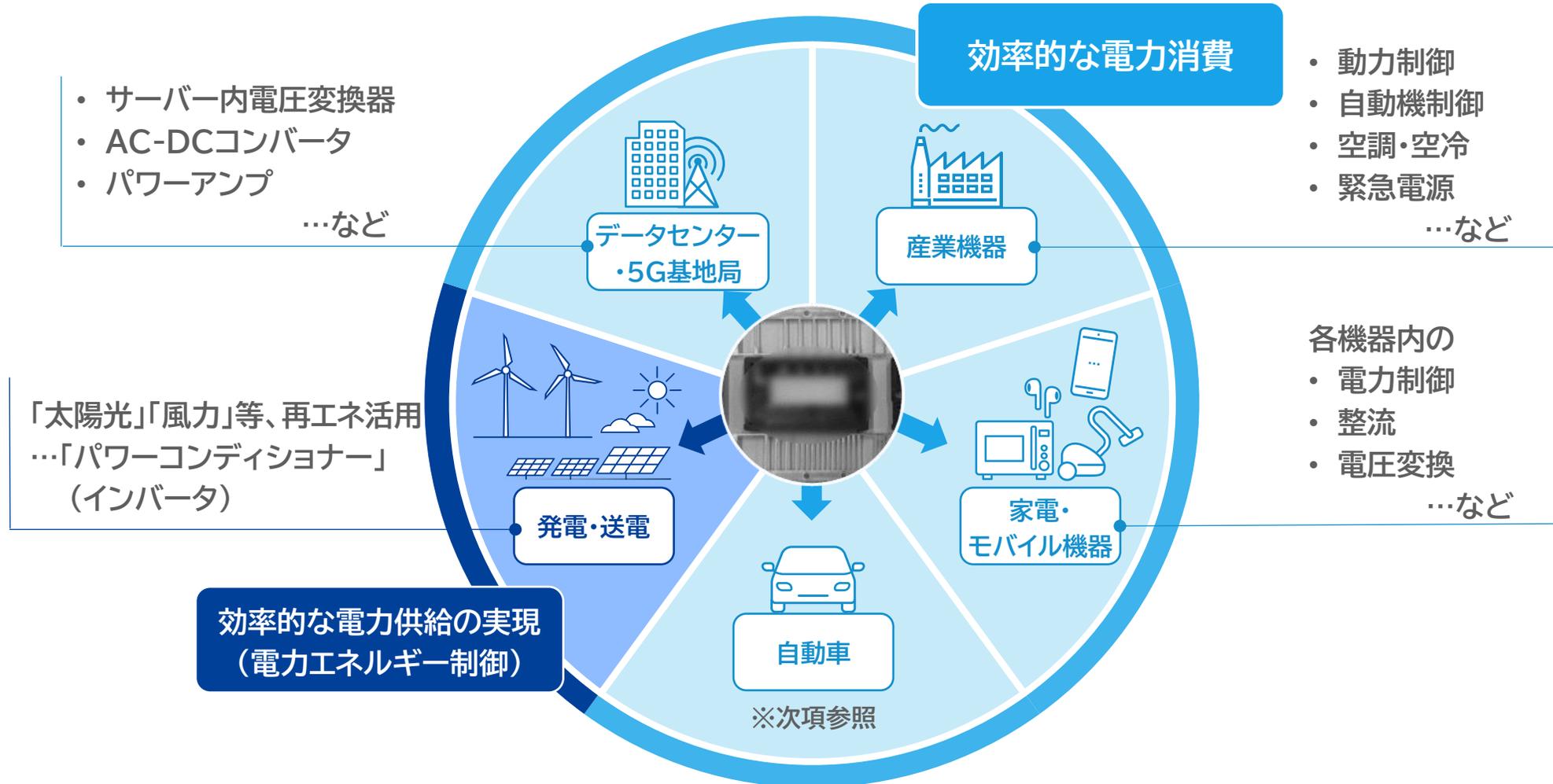
売上高 **3,371**百万円  
 前同比 **+27.3%**  
 構成比 **12.5%**



## (2) 当社製品と強み

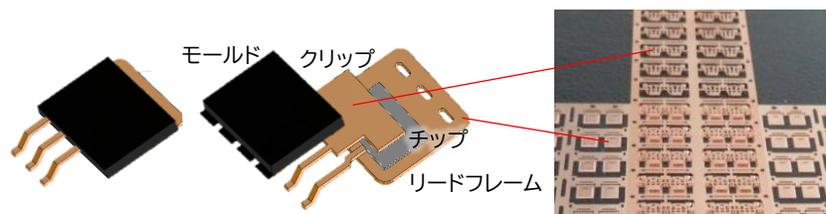


- xEVやデータセンター向けなどに高効率な電力供給を支える高性能パワー半導体に、環境側面からも注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・大電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与

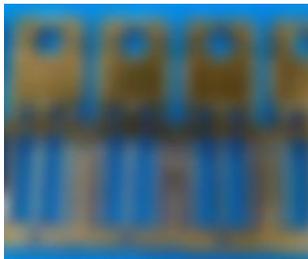


\* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

## クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



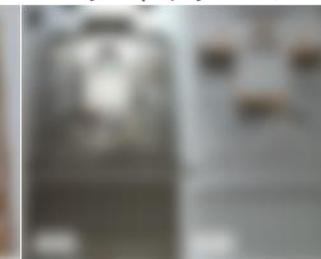
汎用パワー半導体用  
リードフレーム



IGBT用  
リードフレーム



パワーIC用  
リードフレーム



## パワーデバイス適用製品

計**40**品種以上

### パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- レギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



### 車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

### ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

- 車載ECU\*1やデータセンター向けパワー半導体の高電圧・大電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディングの注目が高まる
- 需要は拡大しており2023年3月期に計画前倒しでリードフレームの生産能力を増強平坦度などの品質要求が高く付加価値率も高い
- GaNチップ向けの新製品に着手

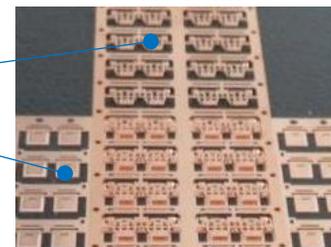
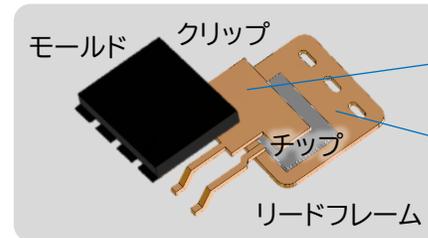


従来品を上回る高信頼性と省スペース性

## クリップボンディングリードフレーム

高耐熱性

長寿命化



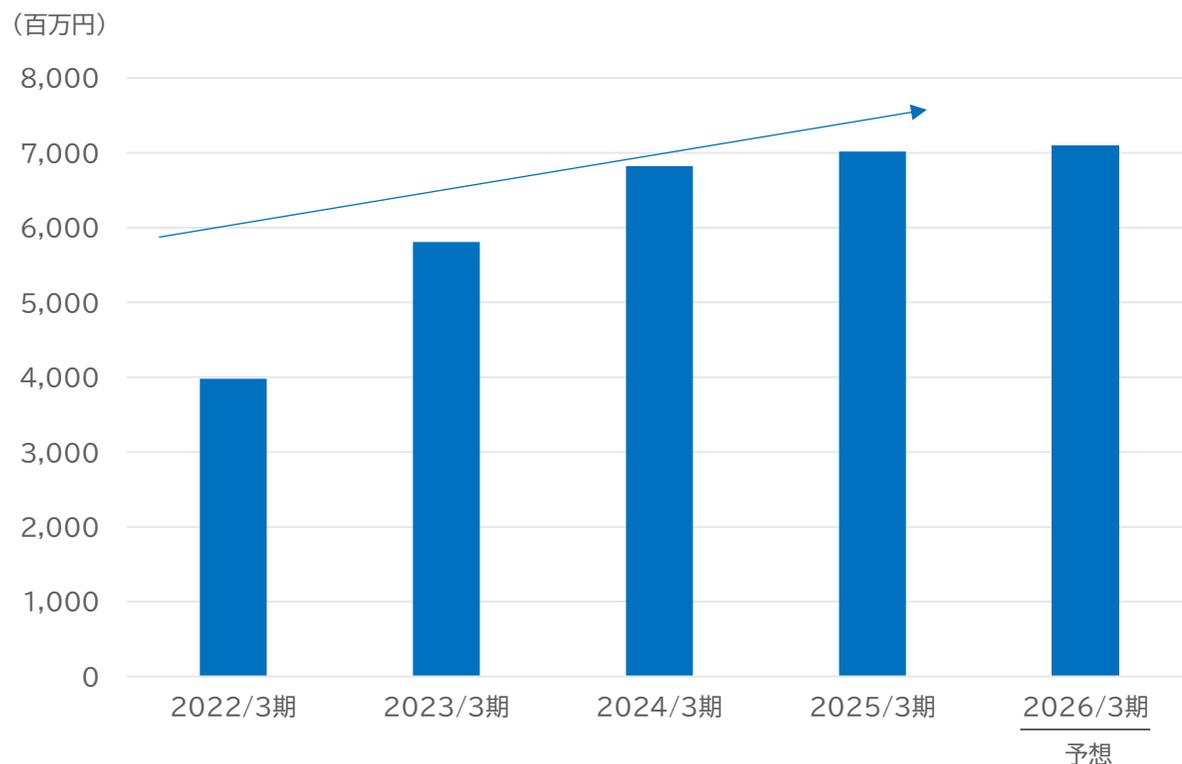
- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度(位置精度)が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

平坦度(位置精度)・清浄度の要求が高く、高い付加価値率

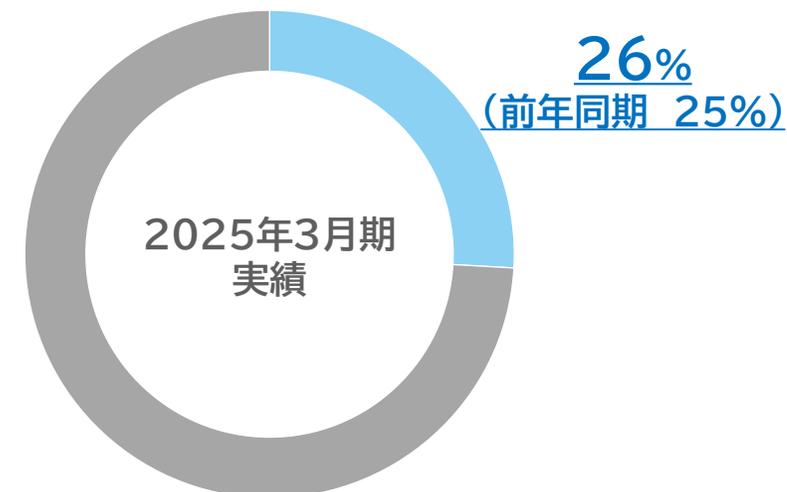
\*1 ECU Electronic Control Unit

- 当社のパワー半導体用リードフレームに占める車載向けは調整しつつも確実に成長
- 世界上位のパワー半導体メーカーに向けてクリップボンディングリードフレームなどの拡販を図りリードフレーム事業の利益率向上を目指す

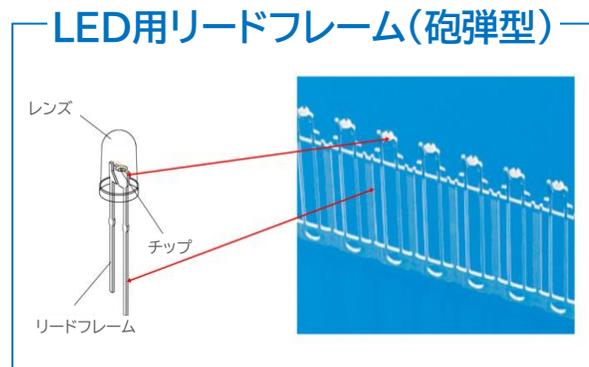
### 車載向けパワー半導体用リードフレームの売上高推移



### パワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの構成比

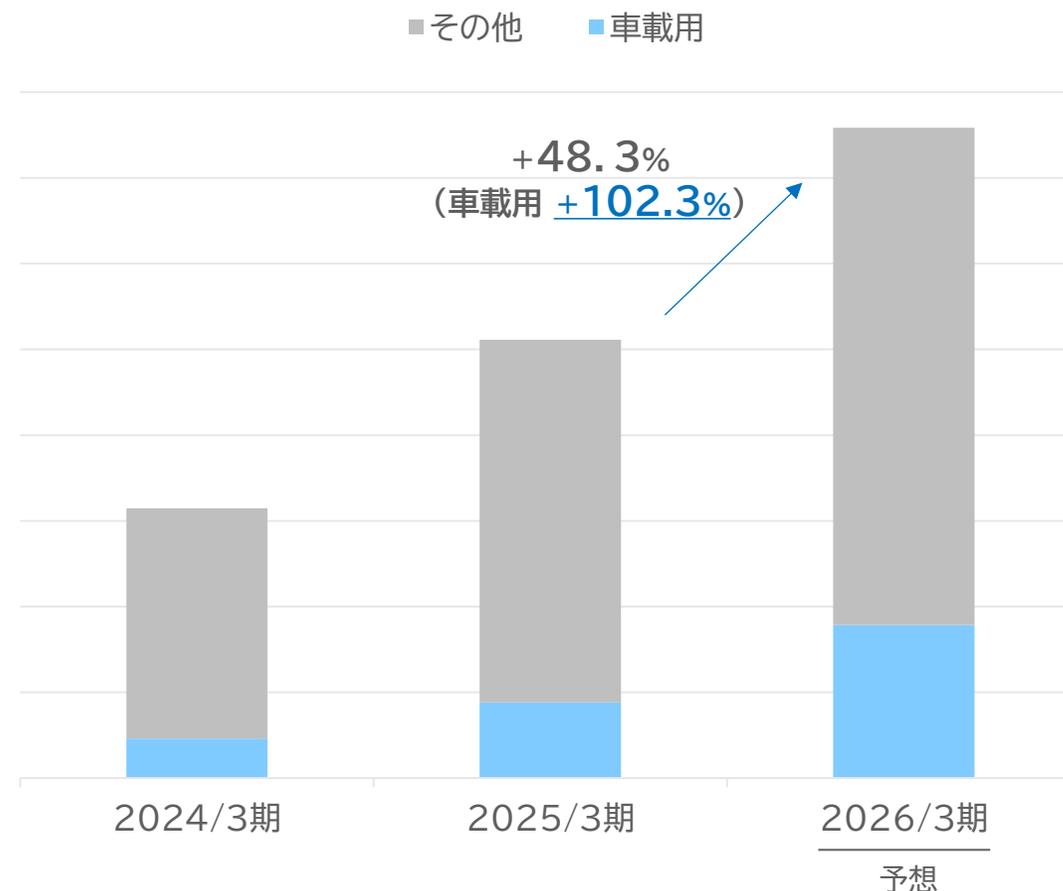


- アンビエントライト向けなどハイエンド分野で成長を図る
- LEDの輝度を安定させるためには、リードフレームの平滑性などの品質が重要

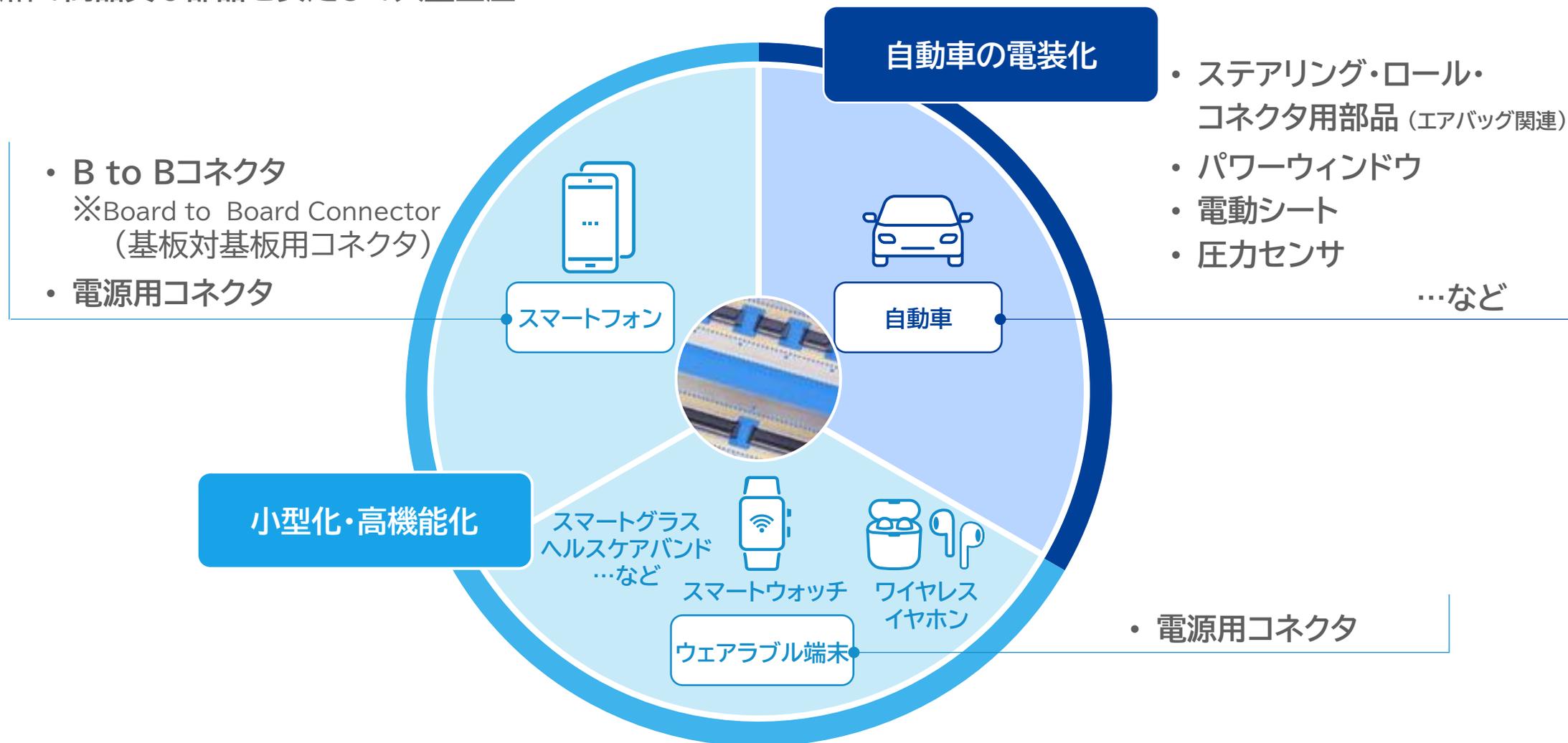


- 砲弾型のリードフレームを大量生産できる、国内唯一のメーカー
- SMDタイプでは1サイクルで多数の成形を行い、高い生産効率、大量生産を実現

LED用リードフレームの売上高推移(金型含む)

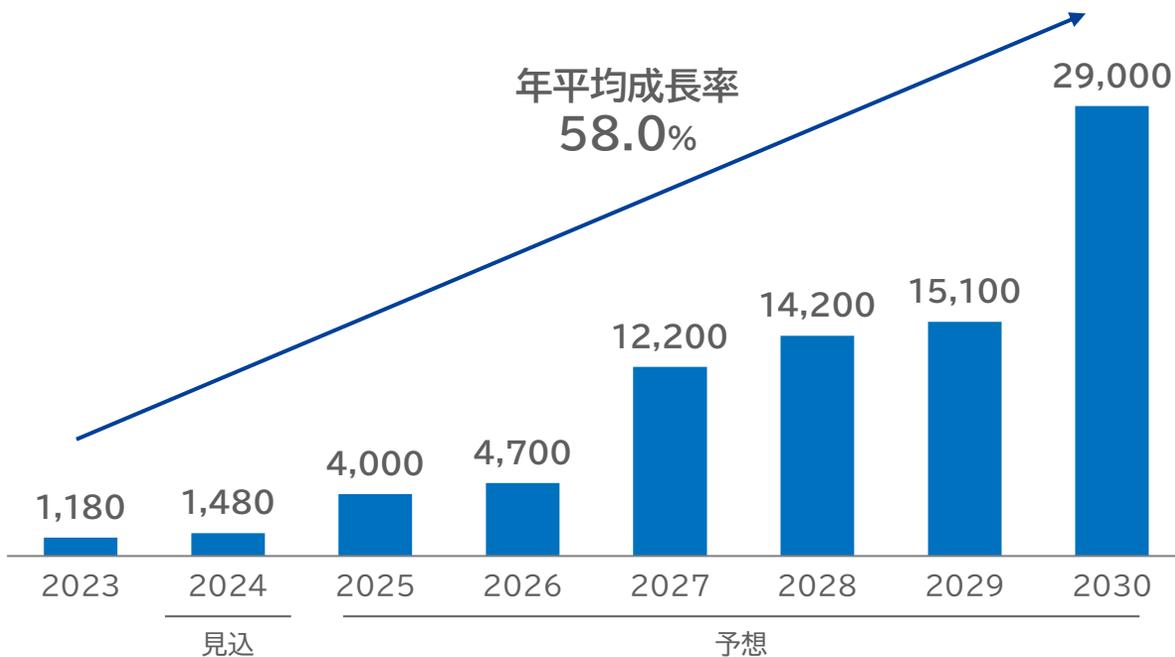


- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細で高品質な部品を安定して大量生産

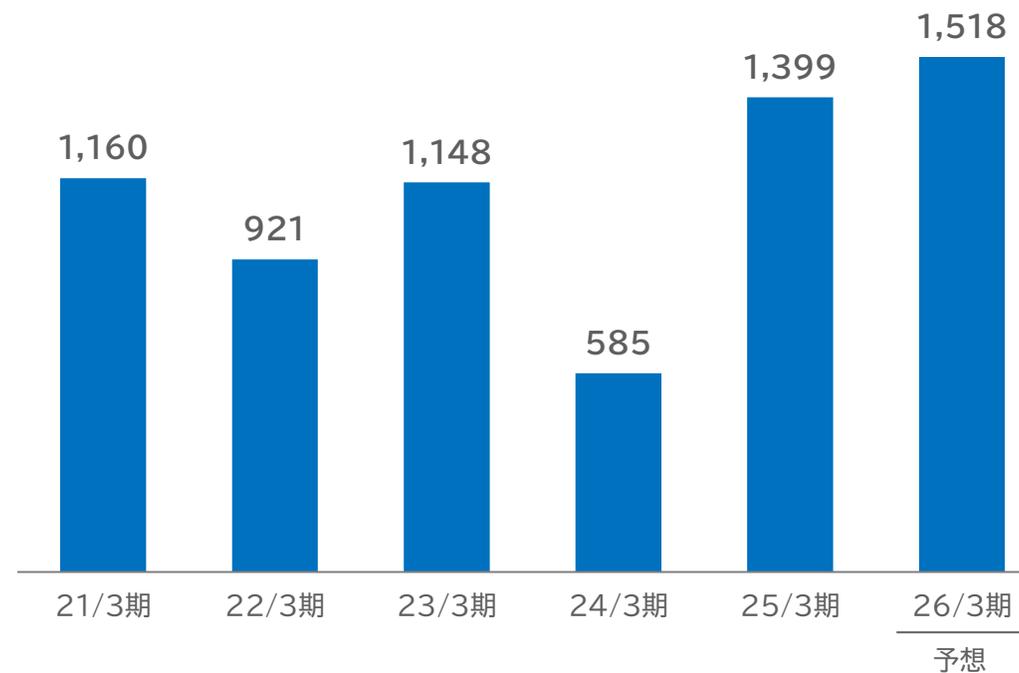


- ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ向けは在庫調整局面を脱して再成長
- 新たなデバイスとしてはスマートグラス向けなどに市場拡大の期待

## スマートグラス用導光板の市場予測 出荷数量\*(千枚)



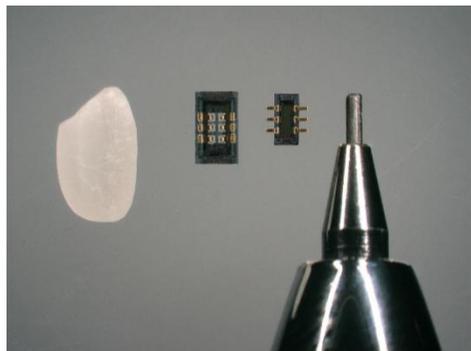
## ウェアラブル端末向けコネクタの売上高推移 (百万円)



\*スマートグラス用コネクタの出荷量は導光板の出荷量に比例  
出所:富士キメラ総研「2024 イメージング&センシング関連市場総調査」

1

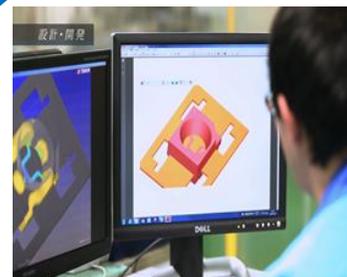
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

高品質・大量生産体制を支える  
生産技術力

2



3

海外でも日本品質の生産体制

中国

クリップボンディング  
リードフレームで先行



フィリピン

車載向けコネクタ用部品の  
主力工場



一貫生産

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや  
協力会社

幅広い顧客  
ニーズ

最適な調達

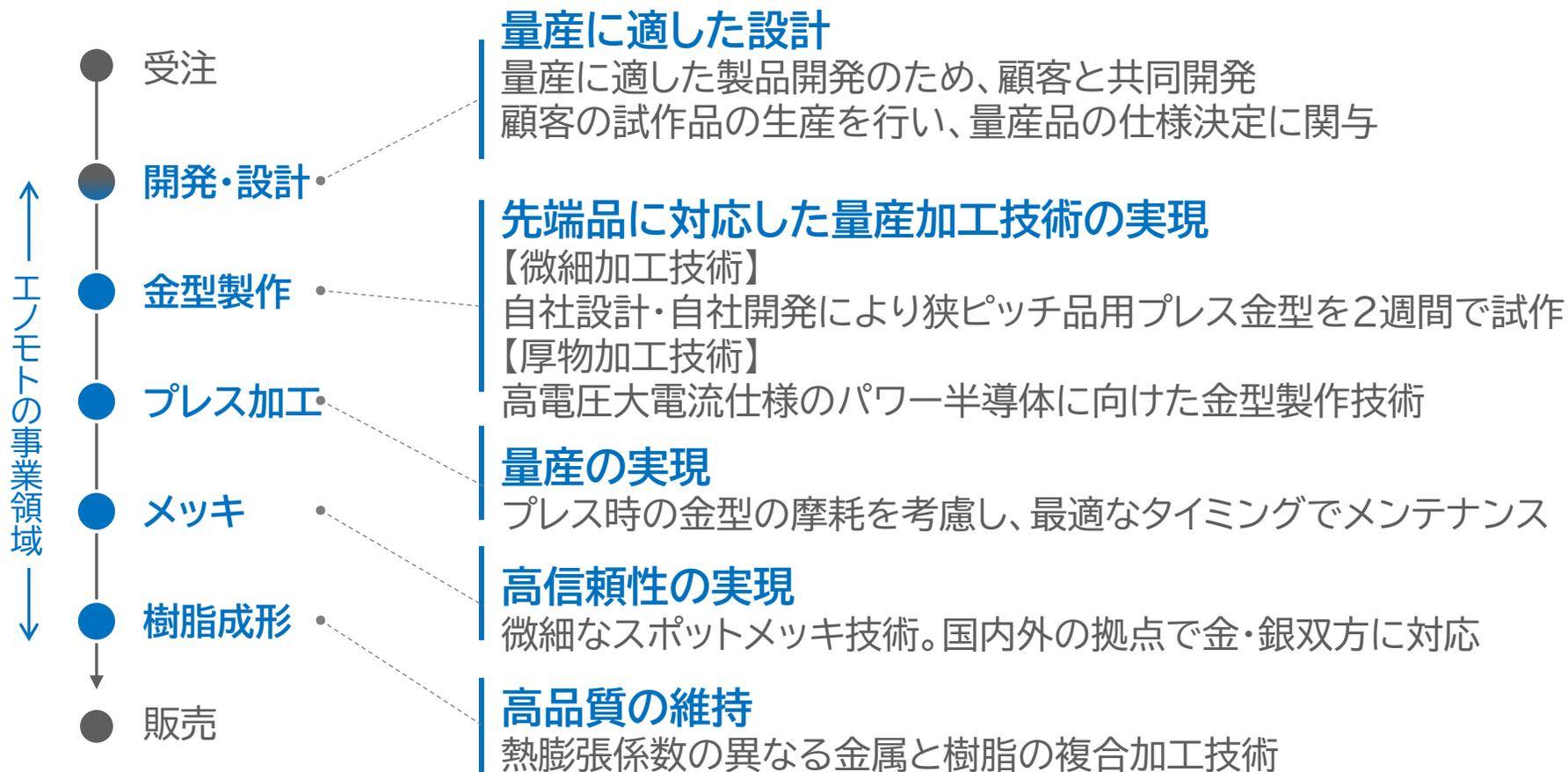
エノモト

柔軟な対応

特定の資本に縛られない  
自由な営業方針

4

- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどのマイクロコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



## (3)2025年3月期決算



- 民生・産業機器向けのパワー半導体用リードフレームの生産調整の長期化も、オプト用リードフレーム、コネクタ用部品は底打ちして増収
- 工場稼働率が改善したことで利益率も向上
- 売上高、利益ともに為替変動の影響等は受けつつも、概ね従来予想通りに着地

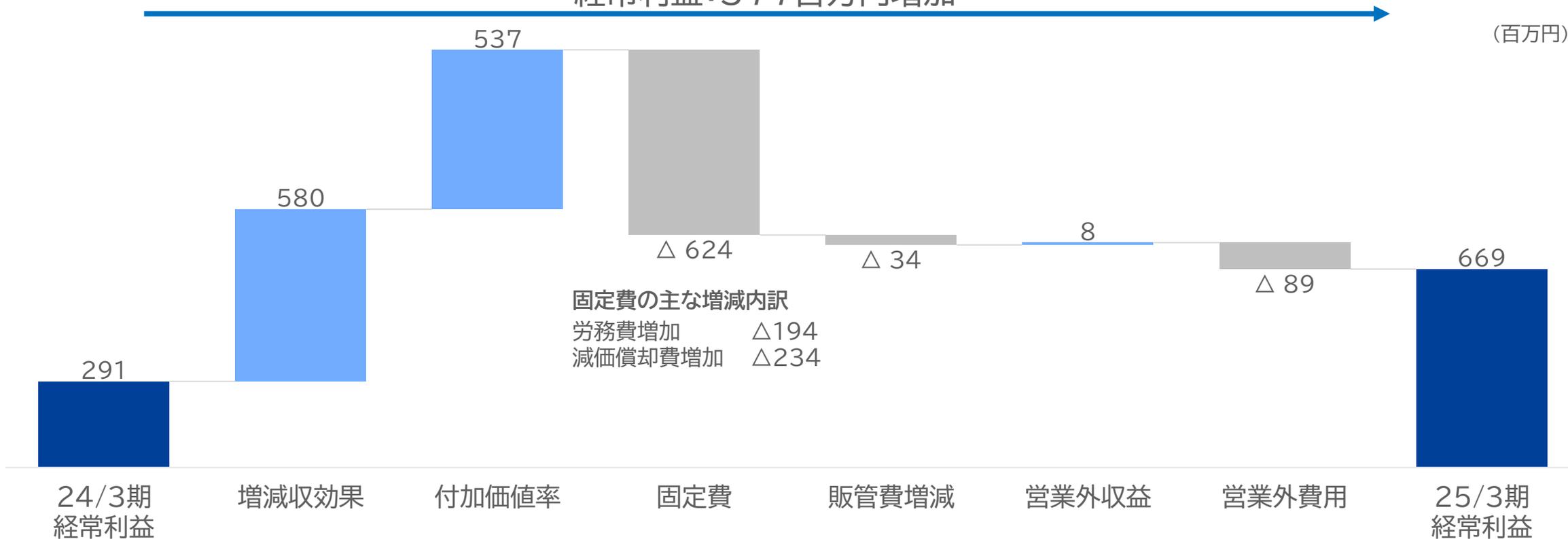
単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前期比(%)
売上高	29,265	100.0	25,244	100.0	<b>26,880</b>	<b>100.0</b>	6.5
売上総利益	4,100	14.0	2,654	10.5	<b>3,147</b>	<b>11.7</b>	18.6
販管費	2,538	8.7	2,494	9.9	<b>2,528</b>	<b>9.4</b>	1.4
営業利益	1,561	5.3	160	0.6	<b>618</b>	<b>2.3</b>	286.0
為替差損益	37	0.1	17	0.1	<b>△65</b>	-	-
受取利息	13	0.1	56	0.2	<b>86</b>	<b>0.3</b>	55.0
経常利益	1,805	6.2	291	1.2	<b>669</b>	<b>2.5</b>	129.3
当期純利益	1,269	4.3	121	0.5	<b>447</b>	<b>1.7</b>	269.3
1株当たり純利益	190.02円	-	18.16円	-	<b>68.51円</b>	-	
1株当たり配当金	60.0円		70.0円		<b>71.0円</b>	-	

- パワー半導体用リードフレームは車載向けの成長が鈍化、民生・産業機器向けの在庫調整も続いた
- オプト用リードフレームは、ハイエンド品の民生向けが車載向けに先行して量産開始
- コネクタ用部品はスマートフォン向けと車載向けは、ほぼ横ばいだが、ウェアラブル端末向けが底打ちし再成長

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,112	44.0	10,771	40.1	△3.1
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,647	10.5	3,371	12.5	27.3
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,989	43.5	12,085	45.0	10.0
その他	659	2.3	495	2.0	651	2.4	31.6
合計	29,265	100.0	25,244	100	26,880	100	6.5

- 増減収効果                    ウェアラブル端末向け等のコネクタ用部品が増収、オプト用リードフレームも増収トレンドへ
- 付加価値率(ミックス改善) ①マイクロコネクタやクリップボンディングリードフレームの増加  
②ハイエンドLED向けのオプト用リードフレームの増加
- 固定費                         生産能力増強に伴い金型等の減価償却費増加、稼働率上昇により労務費も増加

経常利益:377百万円増加



- 車載はパワー半導体用リードフレームは成長がやや鈍化、エアバッグ用コネクタは横ばい
- スマートフォンは前年比でやや減少、ウェアラブルが回復
- 民生・産機・その他の汎用パワー半導体用リードフレームが調整継続、LEDはハイエンド品の金型売上及び量産が始まり増加

## 民生・産機・その他

- 構成比は前期の28.4%から 0.4pt増加  
前期比 5.2%増加
- PC向けを含む汎用パワー半導体用  
リードフレームの在庫調整
- LED用リードフレームはハイエンド品  
出荷開始により増加

## ウェアラブル

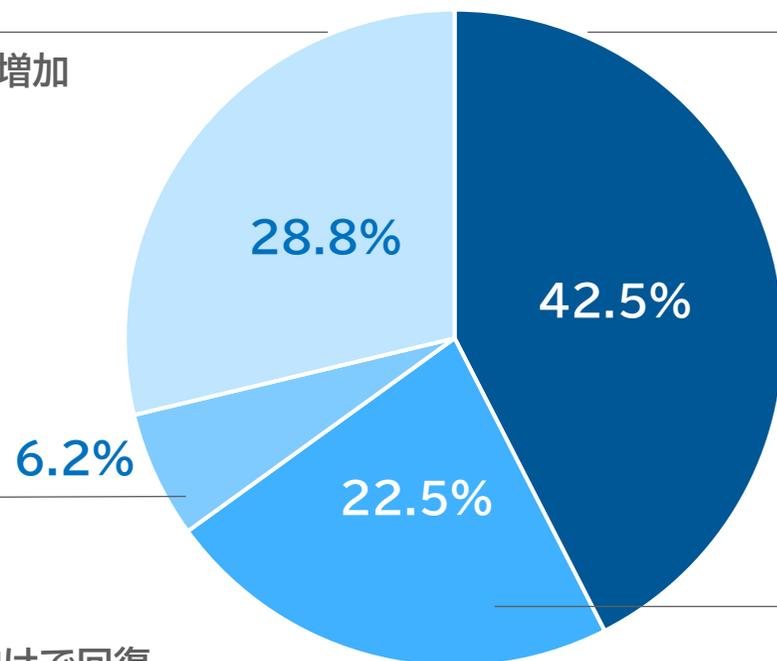
- 構成比は前期の2.7%から 3.5pt増加  
前期比 138.9%増加
- ワイヤレスイヤホンやウォッチの新製品向けで回復

## 車載

- 構成比は前期の44.5%から 2.0pt減少  
前期比 1.0%減少
- xEV向けパワー半導体用リードフレームは成長鈍化
- エアバッグ向けコネクタ等は横ばい

## スマートフォン

- 構成比は前期の24.4%から 1.9pt減少  
前期比 4.4%減少
- スマートフォン向けコネクタ部品は、やや減少



- 第4四半期はスマートフォンなどで季節調整があったが、オプト用リードフレームの増収等から前年同期比増収
- 利益面では、稼働率の上昇やオプト用リードフレームのハイエンド品や、コネクタ用部品のマイクロコネクタなど付加価値の高い製品の増加や稼働率の向上により前年同期比で増益

単位:百万円	2024/3期				2025/3期				前同比 (%)	3Q比(%)
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	6,426	6,593	6,169	6,053	6,506	6,912	<b>6,917</b>	<b>6,543</b>	+8.1	△5.4
売上総利益	722	642	730	558	749	902	<b>877</b>	<b>617</b>	+10.6	△29.6
販管費	590	637	626	639	645	648	<b>620</b>	<b>614</b>	△4.0	△1.1
営業利益	132	4	103	△80	104	253	<b>256</b>	<b>3</b>	-	△98.5
為替差損益	12	16	△41	29	5	△61	<b>35</b>	<b>△45</b>	-	-
経常利益	162	27	89	12	135	228	<b>332</b>	<b>△26</b>	-	-
四半期純利益	96	△9	29	3	47	223	<b>140</b>	<b>37</b>	+846.1	△73.4

- 売上高は2024年3月期4Qをボトムに回復トレンド
- パワー半導体用リードフレームはEV向けの成長が一時鈍化、民生・産機向けは調整が続いた
- オプト用リードフレームはハイエンド品の量産により、増収トレンド入り
- コネクタ用部品はスマートフォン向けが季節調整、車載向けは横ばい、ウェアラブル端末向けは増加

単位:百万円	2024/3期				2025/3期				前同比 (%)	3Q比 (%)
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
パワー半導体用 リードフレーム	3,164	2,832	2,516	2,598	2,662	2,734	2,738	2,637	+1.5	△3.7
オプト用 リードフレーム	712	662	648	624	728	742	901	998	+59.9	+10.8
コネクタ用部品	2,437	2,970	2,863	2,717	2,959	3,248	3,114	2,763	+1.7	△11.3
その他	112	129	141	112	156	188	163	144	+28.3	△11.8
合計	6,426	6,593	6,169	6,053	6,506	6,912	6,917	6,543	+8.1	△5.4

## (4) 2026年3月期業績予想



- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品が民生向けに続き車載向けも順次量産開始の予定で、着実な成長が続く
- ・ メッキや樹脂成形が必要な高付加価値製品をターゲットに受注活動強化、製造工程の自動化を加速し、増益を予想
- ・ 米国の関税政策による直接的な影響は僅少だが、金融・為替相場の混乱による景況の悪化など間接的な影響を注視

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期予想		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	25,244	100.0	26,880	100.0	<b>27,000</b>	<b>100.0</b>	+0.4
売上総利益	2,654	10.5	3,147	11.7	<b>3,600</b>	<b>13.3</b>	+14.4
販管費	2,494	9.9	2,528	9.4	<b>2,600</b>	<b>9.6</b>	+2.8
営業利益	160	0.6	618	2.3	<b>1,000</b>	<b>3.7</b>	+61.6
経常利益	291	1.2	669	2.5	<b>1,050</b>	<b>3.9</b>	+56.9
当期純利益	121	0.5	447	1.7	<b>700</b>	<b>2.6</b>	+56.3
1株当たり当期純利益	18.16円	-	68.51円	-	<b>107.07円</b>	-	-
配当金	70.0円	-	71.0円	-	<b>71.0円</b>	-	-

- ・ パワー半導体向けリードフレームは中国の民生・産業機器向けが調整継続
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の量産が順次開始、増収が続く
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向けとウェアラブル端末向けが堅調に推移

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,112	44.0	10,771	40.1	<b>10,000</b>	<b>37.0</b>	△7.2
オプト用 リードフレーム	2,647	10.5	3,371	12.5	<b>4,300</b>	<b>15.9</b>	+27.6
コネクタ用部品	10,989	43.5	12,085	45.0	<b>12,200</b>	<b>45.2</b>	+1.0
その他	495	2.0	651	2.4	<b>500</b>	<b>1.9</b>	△23.3
合計	25,244	100	26,880	100.0	<b>27,000</b>	<b>100.0</b>	+0.4

- ・ パワー半導体向けリードフレームは足下は中国向けの民生・産業機器向けが調整継続
- ・ オプト用リードフレームは新規の受注案件が順次量産・出荷開始で確実な成長
- ・ コネクタ用部品は在庫調整が終了し、特にウェアラブル端末向けで市場成長による増加を見込む

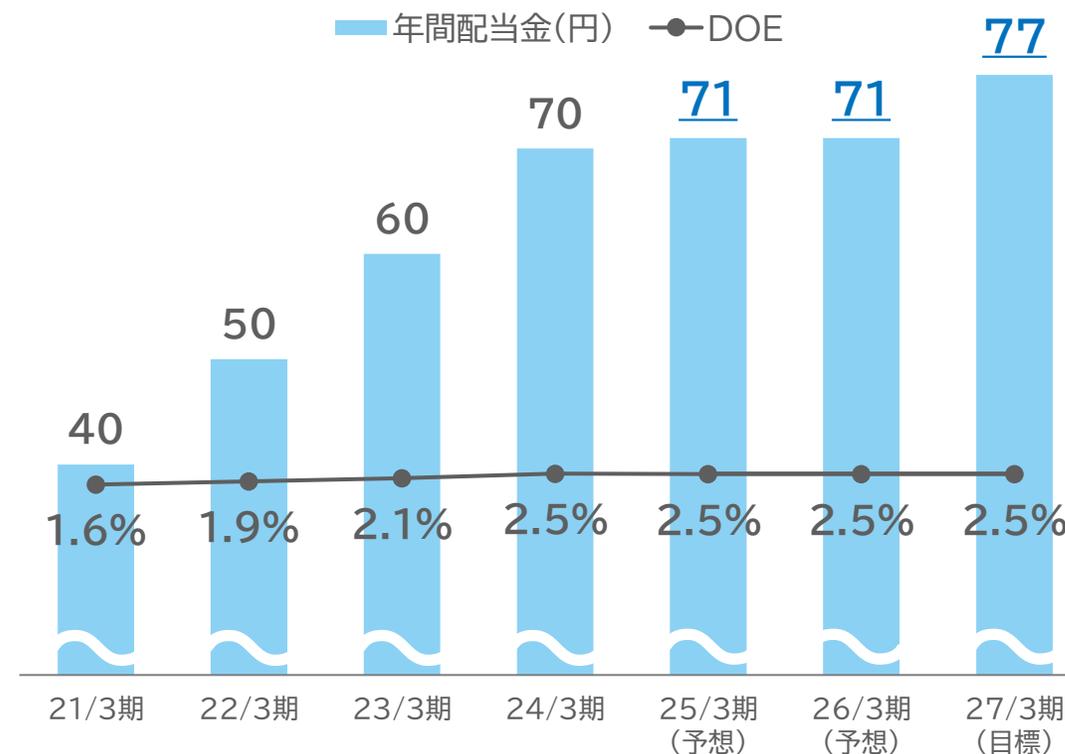
単位:百万円 矢印:前年同期比での方向性	2024/3期		2025/3期		2026/3期	2026/3期の方向性
	上期	下期	上期	下期		
パワー半導体用リードフレーム	5,996	5,115	5,396	5,375	10,000	
車載向け						EV市場の成長鈍化や世界的な新車需要減速の影響。
民生・産機向け						調整局面が継続。回復時期は不透明。
オプト用リードフレーム	1,374	1,272	1,470	1,900	4,300	
車載向け						新規受注のハイエンド品の量産が本格化。
民生向け						新規受注のハイエンド品の生産増加。
コネクタ用部品	5,408	5,581	6,208	5,877	12,200	
車載向け						ADAS拡大状況しだいで上振れも。
モバイル向け						前期並の予想だが、新モデルの販売次第で増加の可能性あり。
ウェアラブル向け						在庫調整終了。市場成長に増加を予想。

- 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更、2025年3月期は71円(DOE2.5%)への増配を計画
- 2026年3月期もDOE2.5%以上となる71円の配当を継続

## 2024年3月期以降の配当方針

- DOE\*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2025年3月期は71円配当を予定(DOE2.5%)

## 配当金・DOEの推移



\* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

(5)中期経営計画『ビジョン2030 2<sup>nd</sup> STEP』進捗  
(2025年3月期～2027年3月期)





## ビジョン2030

## 「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で 暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

## ——— ありたい姿 ———

## 技術

- AI化と無人化による金型技術の進化で常に最先端の市場に向けて高品質な部品をスピーディーに提供し続ける

## 人材

- 失敗を恐れずチャレンジし多様な人財が活躍できる職場環境づくりを通じてイノベーションを生み新たな企業価値を創造する

## 環境

- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する
- 社会環境におけるリスクと機会を的確にとらえて行動することで信頼される企業であり続ける

- ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケット成長を上回る売上・利益成長を図る
- 2nd STEPでは、車載向けリードフレームの生産拡大、ハイエンドLEDの強化、メッキ内製化による付加価値向上を実現する
- 生産面では、精密加工の無人化、スマートファクトリー実現に向け、データの共有化やビッグデータの構築と見える化を推進する



- 自動車向けパワー半導体用リードフレームやハイエンドLED等の成長分野への投資により、2nd STEP最終年度は売上高300億円を計画
- 増収に加えて、メッキ工程の内製化やスマートファクトリーの推進による生産効率向上により営業利益は24億円、利益率も8.0%を計画

## 1st STEP実績(3カ年平均)

売上高  
272億円

営業利益  
12億円

ROE  
4.7%

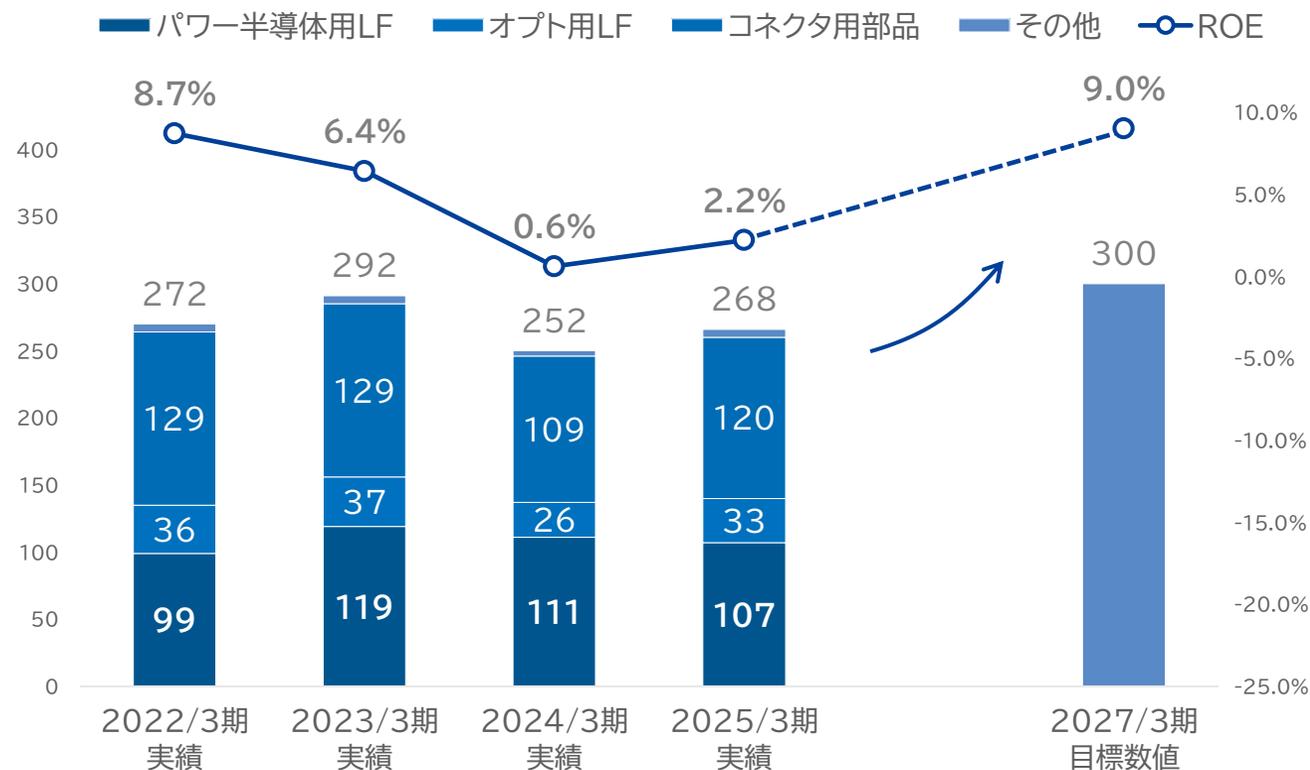
## 2nd STEP最終年度 目標数値

売上高  
300億円

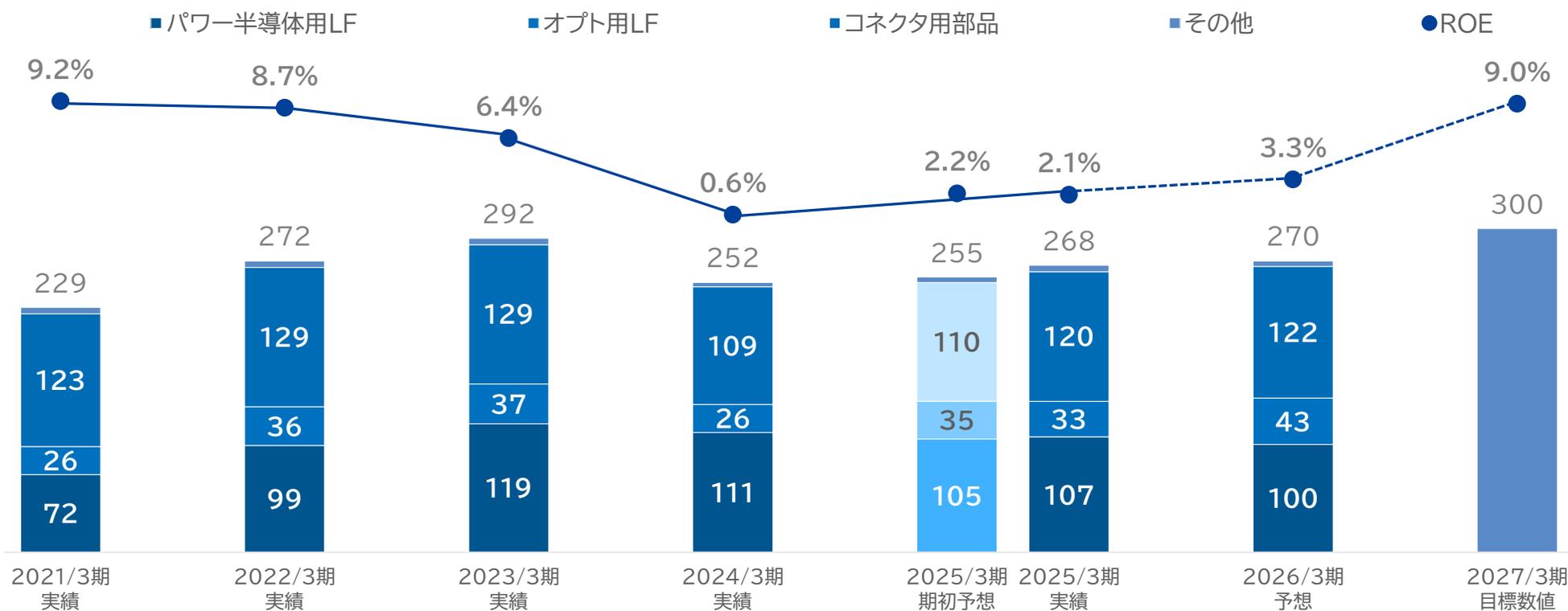
営業利益  
24億円  
(利益率8.0%)

ROE  
9%

## 売上高・ROE



- 中期経営計画初年度の2025年3月期は水準は低いものの、期初計画を上回る売上高と利益を計上
- 2026年3月期もオプト用リードフレームの増加などにより増収増益を予想



- ・ パワー半導体用リードフレームは再成長に向けた、複数の次世代製品引合いに対応中
- ・ オプト用リードフレームは受注済み案件の量産立上げに注力し、確実な成長を見込む
- ・ コネクタ用部品は既存製品の調整完了による再成長に加え、ウェアラブル端末向けなどの新製品受注で高難度への挑戦継続

	主要施策	2027年3月期売上目標
パワー半導体用 リードフレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 材料メーカーや協力会社とのタイアップによる、顧客のニーズにマッチした提案の強化</li> <li>・ 新規顧客に向けた次世代製品の拡販</li> </ul>	2024/3期 111億円 → 2027/3期 <b>120億円</b>
オプト用 リードフレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全社的な増産体制の構築(津軽工場の最大活用)</li> <li>・ さらなる受注拡大に向けた生産技術力の強化</li> </ul>	2024/3期 26億円 → 2027/3期 <b>50億円</b>
コネクタ用部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 狭ピッチ・低背化への挑戦</li> <li>・ 技術者の育成</li> <li>・ 一貫生産体制のさらなるレベルアップ</li> </ul> 「最高レベルの品質」「価格競争力」「安定供給」	2024/3期 109億円 → 2027/3期 <b>125億円</b>

- 金型製作において、1st STEPでは経験値の可視化を実施、2nd STEPでは経験値・職人技を共有し、精密加工の無人化を進める
- 量産工程では、1st STEPで津軽工場・エノモト中山(中国)にメッキラインを増設、津軽では2025年度モデルの認定取得し中国はほぼフル稼働

## 主な製品の製造工程と収益力・現場力向上施策



- 1st STEPではIoT×新ERPシステムによる「ものづくりの見える化」に着手
- 2nd STEPでは、データの収集と検証を継続して行い、AIの活用に向けた体制整備と「見える化」したデータを活用した生産管理を推進

1st STEP

IoT×新ERPシステムによる  
シームレスに連携したデータの生成  
データのリアルタイム収集の実現

IoT活用



自動倉庫



AGV(無人搬送車)



2nd STEP

ビッグデータの構築  
「見える化」の推進

データの収集・検証

課題の即時把握

経営判断の迅速化



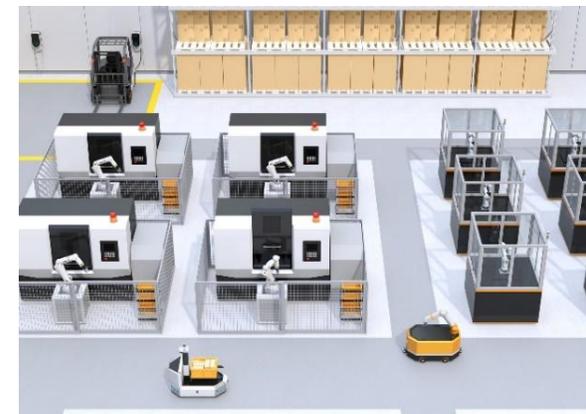
3rd STEP

ビッグデータとAIの活用

高度なスマートファクトリー  
最適化・自動化

AIによる学習・分析

高度な生産計画



- パワー半導体やハイエンドLED、マイクロコネクタ関連の生産対応を中心に50～60億円の設備投資を計画
- 研究開発は燃料電池部品の開発中心に3年間累計で3～5億円を計画



## 主要設備投資

- 新規製品受注による自社製作金型・周辺設備 15億円
- スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- 再エネ・省エネ投資 2億円

\*金型償却費は25/3期 5億円、26/3期予定 7億円

- 営業キャッシュフローによる成長投資の実施と安定的な配当を行い企業価値の最大化を図る
- 自己株式の取得により、株主還元額を期初計画の15億円から20億円に増額
- 2025年3月期は、成長投資へ17億円、株主還元へ10億円

## 3年間のキャッシュアロケーション



- SDGsへの取り組みとして以下を策定し、順調に進捗
- 2022年5月には中期環境計画を定め、2030年のGHG排出削減量を定めて、取り組みを強化  
2023年5月には海外工場等も含む連結での中期環境計画を策定
- 2023年11月に「プラチナくるみんプラス\*」の認定を取得

重点分野	関連するSDGs	現在の取り組み	今後の取組
脱炭素社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 産官学連携による燃料電池部品開発</li> <li>• 太陽光パネルの設置</li> <li>• 照明の完全LED化推進</li> <li>• 中期環境計画の策定と開示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 燃料電池部品の量産ライン稼働実験・量産準備</li> <li>• 中期環境計画の各施策実行・進捗の開示</li> <li>• 非化石電力発電所の設置と非化石証書の段階的活用</li> </ul>
誰もが活躍できる社会の実現	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 子育てのしやすい環境の整備（プラチナくるみんプラス）</li> <li>• 在宅勤務制度の実施</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」</li> <li>• 多様性を重視した管理職育成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度活用促進によるプラチナくるみんプラスの継続</li> <li>• 多様性を重視した管理職育成</li> <li>• 障がい者・外国籍雇用体制の更なる拡充</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」更新</li> </ul>
みんなが幸せになれる社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• フードバンク活動</li> <li>• 学習支援活動への協賛</li> <li>• 地域活動、スポーツ団体への協賛</li> <li>• ボランティア休暇制度実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボランティア休暇取得の促進と活動への組織的な参加</li> <li>• 採用活動や経済活動を通じた総合的な地域との共生</li> <li>• 「モノ」「水」「エネルギー」のリサイクル活動強化</li> </ul>

\*プラチナくるみんプラス：次世代育成支援対策促進法に基づき、「子育て」及び「不妊治療と仕事の両立」支援に取り組んでいる企業を認定



- 生徒の皆さんがフィリピンの子どもに渡す寄付品を当社内で募集
- 活動支援金と寄付品を生徒の皆さんにお渡し
- NPO法人JIYU様の教育支援活動「POSTMAN PROJECT」を通じ、現地に寄付品の支援



- 単体での中期環境計画に加えて、2023年4月にはグループベースでの中期環境計画を策定

当社グループ全体

2030年度 目標

**GHG排出総量** 10,676<sub>t-CO<sub>2</sub></sub>

**GHG排出削減量** 6,488<sub>t-CO<sub>2</sub></sub> (2021年度比 38%削減)

## アクションプラン

1

### 再エネ活用

- 太陽光発電設備の設置
- カーボンフリー電力の購入
- EV車両の導入

2

### 省エネ対策

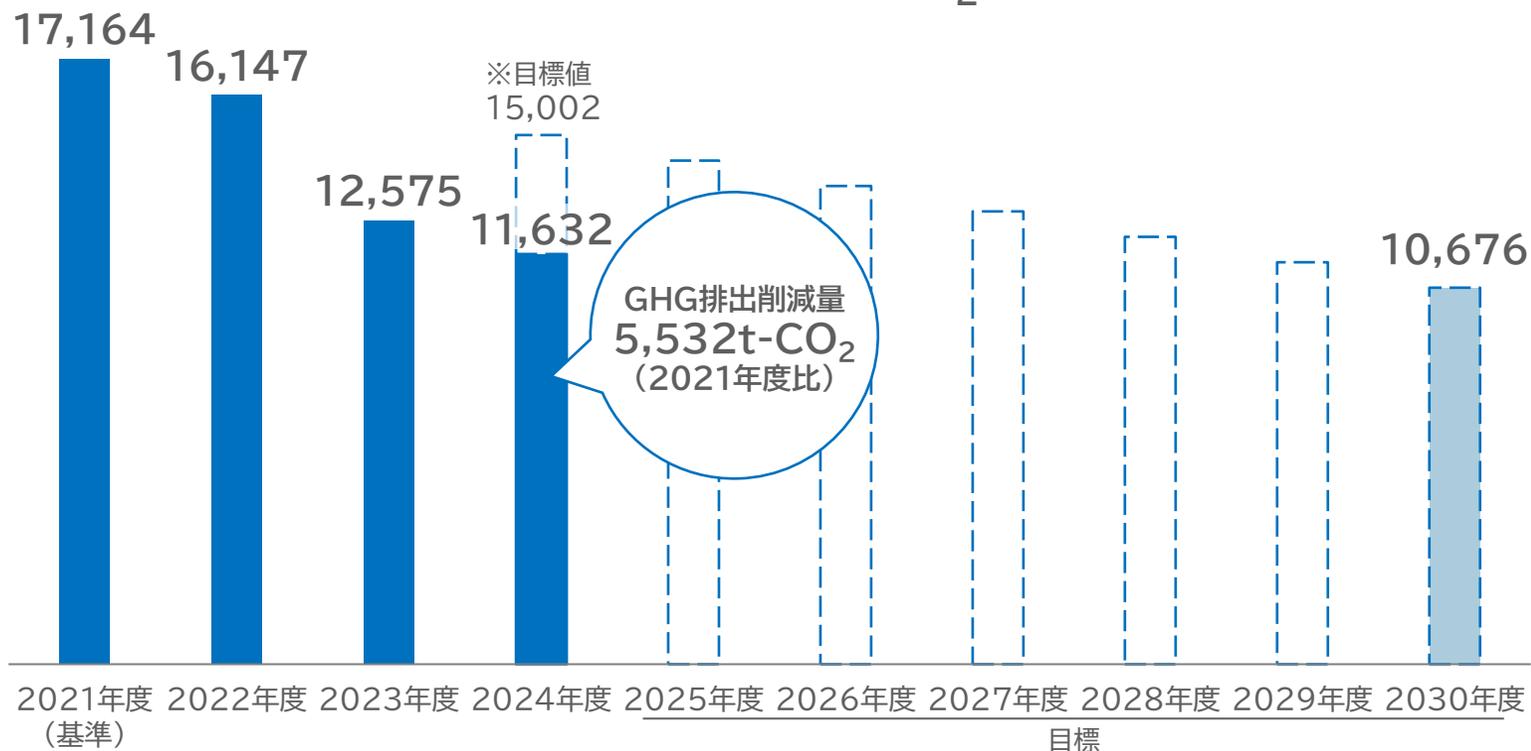
コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

## GHG排出量(t-CO<sub>2</sub>)



\*2024年度に排出量算定ツールを変更した為2021年度の基準値が変更になりました。従って、2030年度目標値および2022年度以降の実績値も変更となります。

## 2024年度の太陽光発電実績

発電量 4,015千kWh  
GHG排出削減量 2,045t-CO<sub>2</sub>

2024年度完成

2025年度稼働開始予定

### ◆本社工場(塩山)社員寮跡地

発電容量: 約250kW

年間発電量: 約410千kWh(想定)

稼働後の発電容量

<効果>

GHG排出削減量

約160t-CO<sub>2</sub>

国内 2.6MW

海外 1.6MW

合計 4.2MW



## 参考情報

本社(上野原)



本社(塩山)



本社(塩山)倉庫屋根



本社(塩山)技術棟屋根



津軽



2024年3月 稼働開始

2023年7月 稼働開始

フィリピン



中国



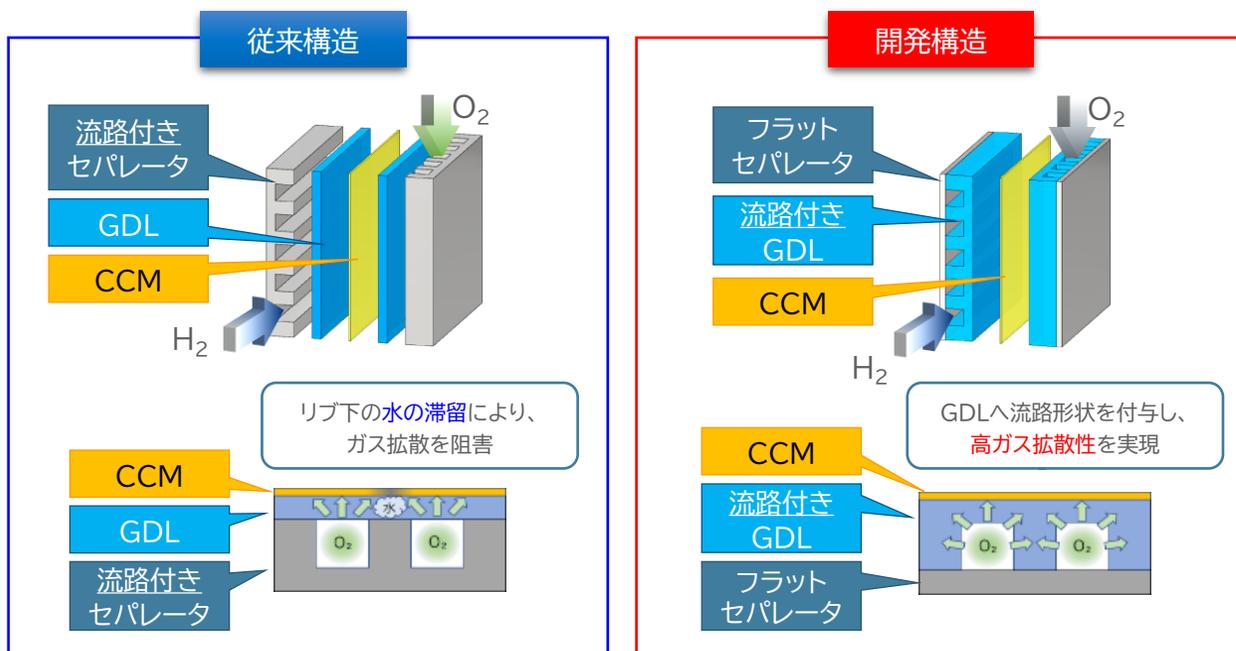
2023年度 増設・稼働

エノモト重川発電所



2025年2月  
愛称公認取得

- 固体高分子型燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- 新開発の流路付きGDL(GDLFC+)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術によりGDLにガス流路を成形
- 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスケットと一体化し、コストを削減
- 市場環境の変化に応じて、大型・商用モビリティ(HDV)向けの燃料電池の開発に注力、将来は電気自動車、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



## 2021年5月

日本で初めて制作された国産の燃料電池を電源とする電動アシスト自転車に当社製「ガス拡散層一体型セパレータ」が搭載

## 2021年7月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 共通課題解決型産学官連携研究開発事業に採択→採択期間は2025年3月まで

## 2022年3月

山梨大学及び大強度陽子加速器施設・J-PARCと 連名で寄稿した論文が『Journal of Power Sources』(ELSEVIER社)にオープンアクセス版として掲載

## 2023年8月

FCyFINEの水素燃料電池アシスト自転車の実証実験として道の駅 富士川(山梨県南巨摩郡富士川町)にてレンタル自転車を5台導入。

## 2023年9月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文\*\*が国際的な学術・技術専門誌「Journal of Power Sources」(ELSEVIER社)オープンアクセス版に掲載。

## 2023年11月

甲府市役所にて日本で初めて水素燃料電池アシスト自転車を公用自転車として導入し実証実験を開始。

⇒次の段階に向け現在も研究継続中

\* 「Improvement of PEFC Performance Stability under High and Low Humidification Conditions by Use of a Gas Diffusion Layer with Interdigitated Gas Flow Channels (対向櫛歯型流路が形成されたガス拡散層が固体高分子型燃料電池セルの高加湿および低加湿条件下における出力安定性の向上に及ぼす影響)」  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac9edf>

\*\* 「Analysis of performance stability under conditions of high & low humidity of polymer electrolyte fuel cells with interdigitated gas flow channels formed on a gas diffusion layer: An X-ray imaging and modeling study (対向櫛歯状ガス流路を形成させたGDLを有する固体高分子型燃料電池の高湿度・低湿度条件下での性能安定性の解析: X線イメージングとモデリングによる検討)」  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775323009990>

- メインターゲットはFCV・HDV\* – 2030年FCV市場規模3兆3,039億円\*\*
- 2025年3月時において特許取得5件、出願中3件(国際:2件、国内:1件)
- 量産目標をクリアすることで2015年比約1/10コスト削減



- 改良型水素燃料電池部品の製造・研究開発・実用化による、安価かつ環境に配慮したエネルギーの普及
- 山梨県、山梨大学等と共に、産官学連携による水素燃料電池の研究開発の推進



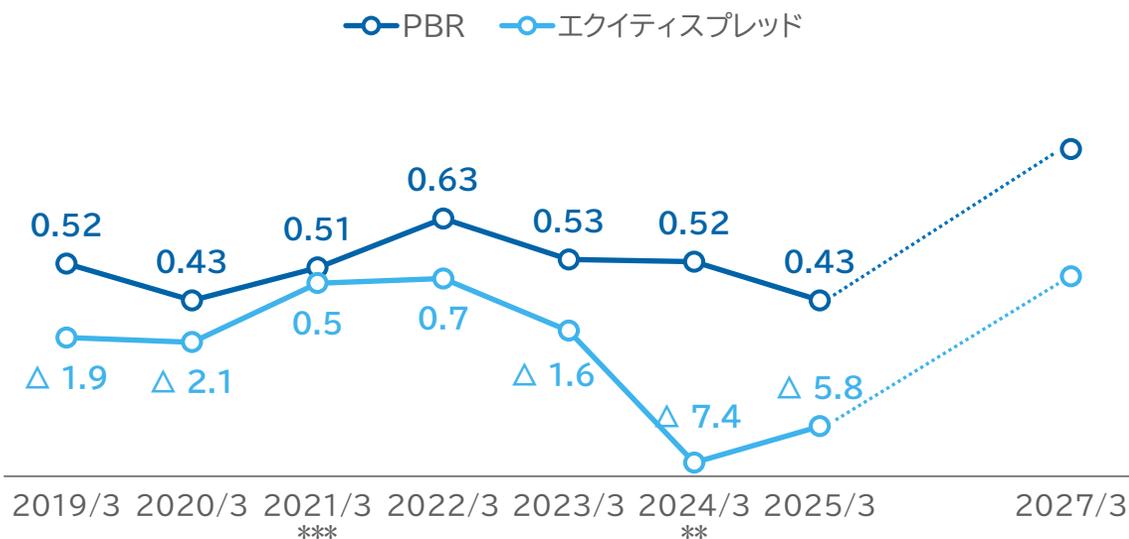
\*HDV heavy duty vehicle  
\*\*FCV市場規模 出所:富士経済・2023年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望

## (6) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて

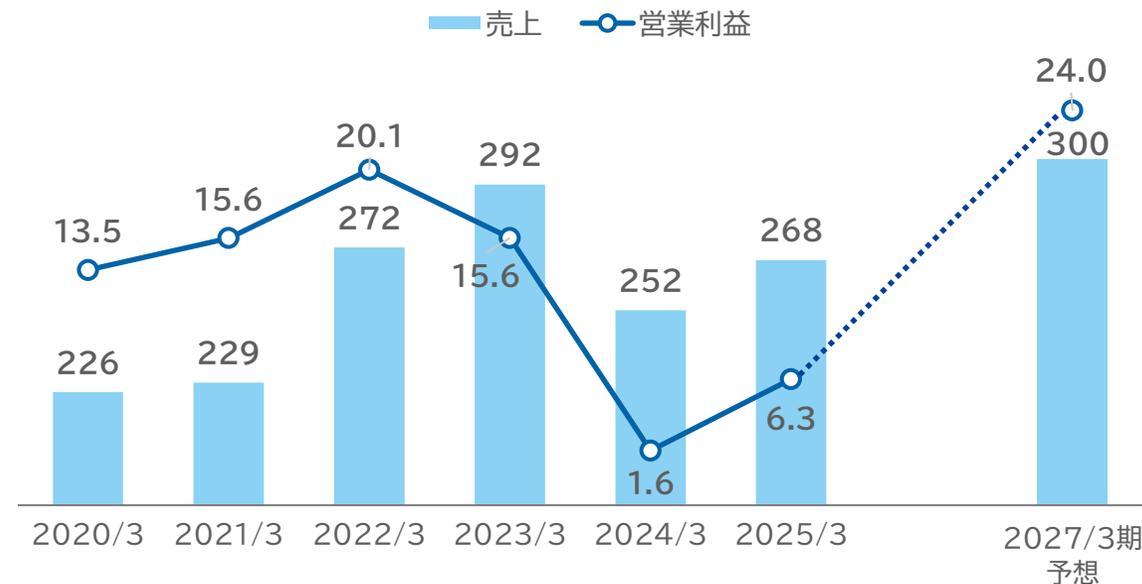


- 株主資本コストは7~8%と認識
- 配当政策DOE発表前のPBRはエクイティスプレッド\*と一定の相関性
- 2ndステップ最終年度の営業利益は24億円を計画、これが達成できれば同期のROEは9%まで高まる見通し  
ROE向上によりエクイティスプレッドを拡大し、PBR向上を目指す

PBR・エクイティスプレッド（単位：%）



売上高・営業利益（単位：億円）



\*エクイティスプレッド=ROE-株主資本コスト(株主資本コストは8%で計算)

\*\* 足元においては配当政策を評価され、配当利回りが株価の下支えとなり  
大幅なマイナスのエクイティスプレッドをカバーしていると推定

\*\*\* 2021/3月期  
繰延税金資産の計上による一時的なROE上昇分を控除

## 企業価値 最大化

ROEの改善  
(ROE 9%目標)

利益率改善・利益成長

- 経営資源の選択と集中  
成長性の高い分野への効率的な資源投下と適切な効率評価
- 付加価値の取込み  
メッキ工程の内製化等

資産効率向上  
ROIC 向上

- 収益性の向上策  
ROICを意識した工場単位での資産効率性管理

株主資本の適正化

- 配当政策  
株主還元の強化:DOE2.5%を下限に増配トレンドを継続

株主資本コスト  
の最適化

$\beta$  値の抑制

- IR活動の充実  
機関投資家向け及び個人投資家向け説明会各2回/年の実施による対話の充実  
統合報告書作成を継続

# Appendix



- 主要原材料仕入先の支払サイト短縮を実施したことで、買掛金等が減少
- ネットキャッシュ409百万円、自己資本比率は66.7%

単位:百万円	2023/3期末	2024/3期末	2025/3期末	前期末比増減
流動資産	19,051	17,133	17,610	+476
（内、現預金）	4,041	5,032	4,445	△586
（内、受取手形及び売掛金及び契約資産）	8,617	6,301	6,077	△224
（内、たな卸資産）	5,720	5,011	6,594	+1,582
固定資産	14,988	15,237	15,224	△13
（内、有形固定資産）	13,501	13,576	13,448	△128
総資産	34,039	32,371	32,834	+463
負債	13,444	11,393	10,932	△461
（内、支払手形及び買掛金）	6,933	5,198	3,968	△1,229
（内、有利子負債）	3,132	3,108	4,036	+927
純資産	20,594	20,977	21,902	+924
負債純資産	34,039	32,371	32,834	+463

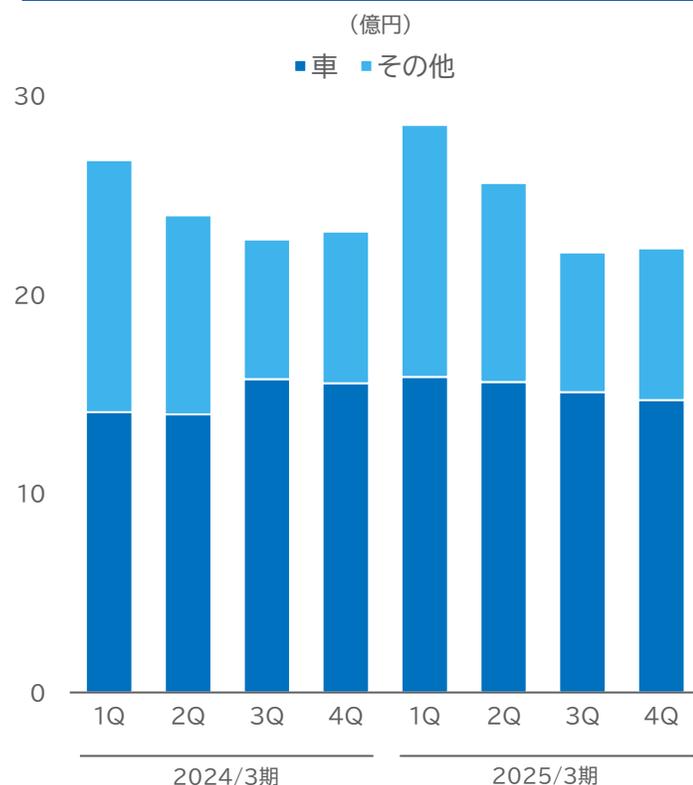
- ・ 営業キャッシュフローは、期初出荷予定の棚卸資産増加や、一部の材料仕入先の支払サイト短縮による
- ・ 津軽工場の増築など大型投資が23年3月期で一巡し、投資キャッシュフローのマイナスも縮小

単位:百万円	2023/3期	2024/3期	2025/3期	前期比増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,810	3,096	732	△2,364
税金等調整前当期純利益	1,664	196	561	365
減価償却費	1,717	1,885	2,182	297
売上債権の増加(△は増加)	△313	2,610	564	△2,046
棚卸資産の増加(△は増加)	△1,057	888	△1,269	△2,158
仕入債務の増加(△は減少)	209	△1,962	△1,422	540
投資活動によるキャッシュフロー	△2,998	△1,757	△1,645	112
有形固定資産の取得による支出	△2,808	△1,955	△1,637	318
財務活動によるキャッシュフロー	535	△511	△98	412
長期借入れによる収入	900	0	900	900
長期借入金の返済による支出	△267	△423	△422	1
配当金の支払い額	△408	△442	△472	△29
現金及び現金同等物の期末残高	4,041	5,032	4,445	△586
フリーキャッシュフロー	△1,188	1,338	△913	△2,252

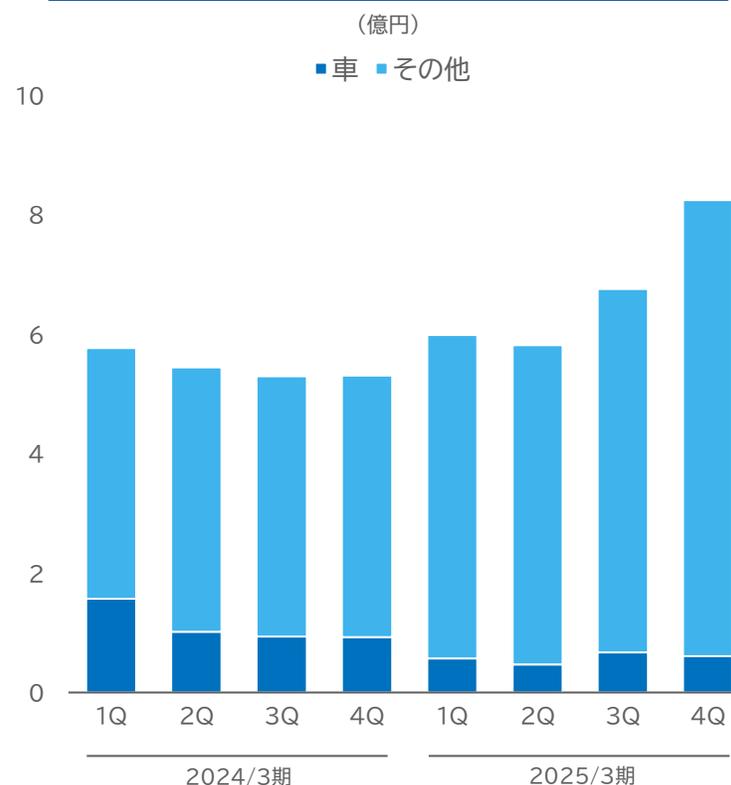
- 2026年3月期はコネクタ用部品の自社金型の型数がさらに増加
- 減価償却費は、自社金型償却費の増加によって今年度も高位に留まる見込み

単位:百万円	2023/3期	2024/3期	2025/3期	2026/3期予想	前期比増減
設備投資	2,979	1,809	1,707	1,860	+153
パワー半導体用リードフレーム	897	500	477	423	△54
オプト用リードフレーム	307	278	112	236	+124
コネクタ用部品	1,136	848	972	1,171	+199
その他(調整等)	637	182	145	28	△117
減価償却費	1,717	1,885	2,182	2,135	△47

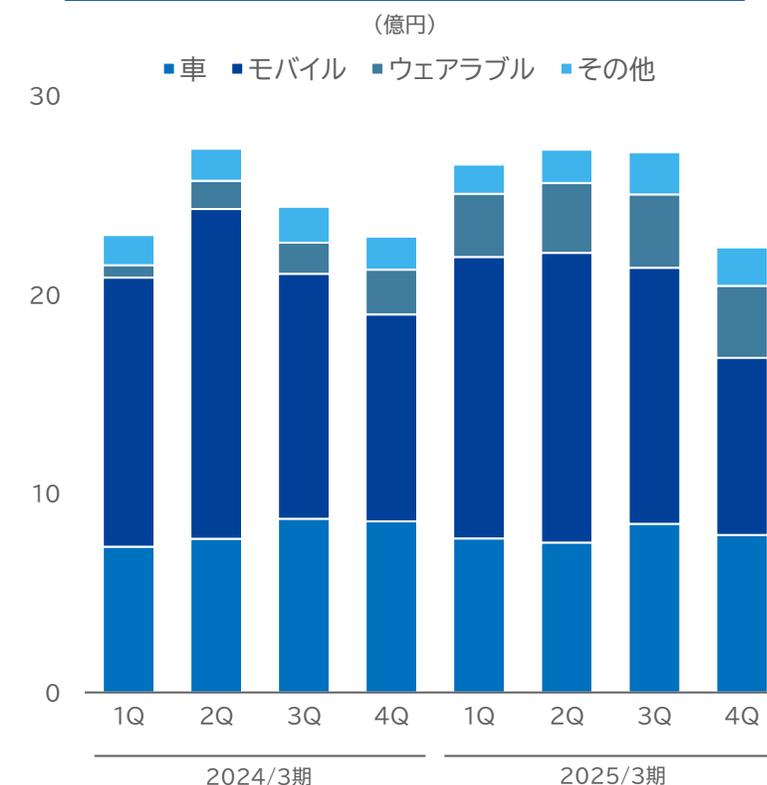
## パワー半導体用リードフレーム



## オプト用リードフレーム



## コネクタ用部品



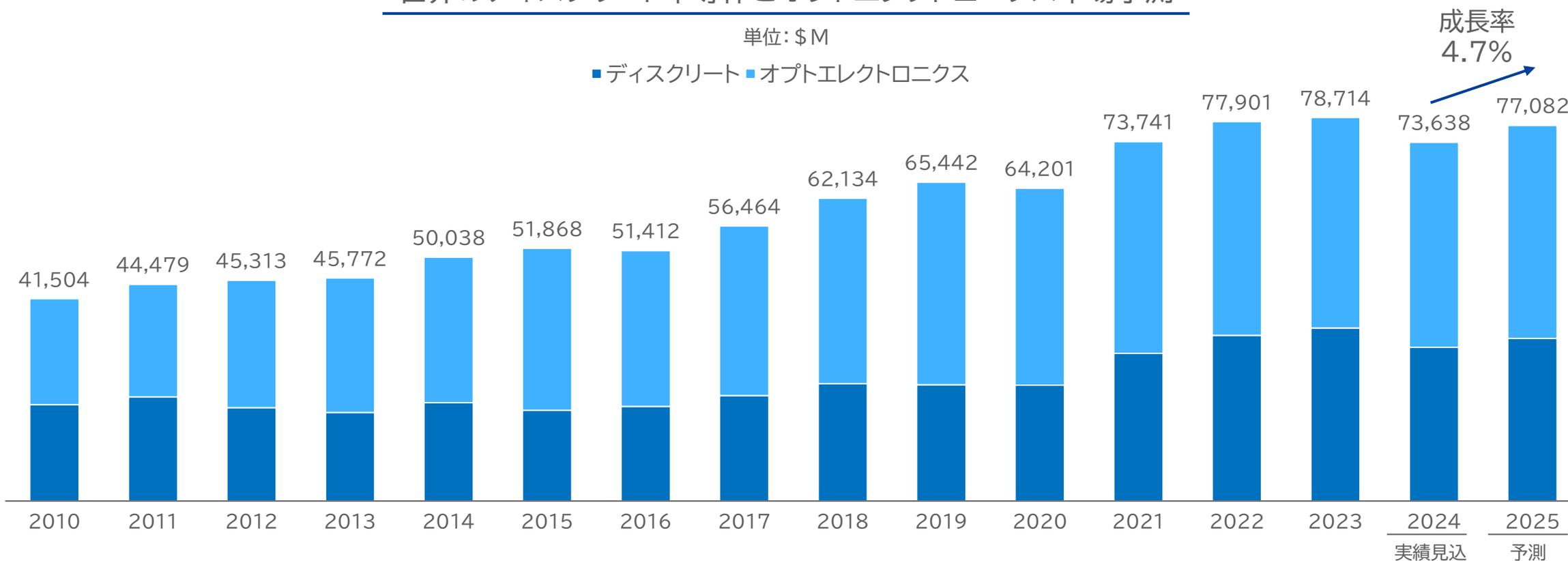
注:用途別量産品売上高は為替レートを固定した売上高で算出しており、製品群別売上高の数値とは一致しない

- ディスクリート市場は、パワー半導体等が車載やデータセンター、5G基地局向けなどの調整底打ち
- オプトエレクトロニクス市場は、車載向けの搭載率上昇や、デジタルサイネージ・大型ディスプレイの需要回復を見込む

## 世界のディスクリート半導体とオプトエレクトロニクス市場予測

単位: \$M

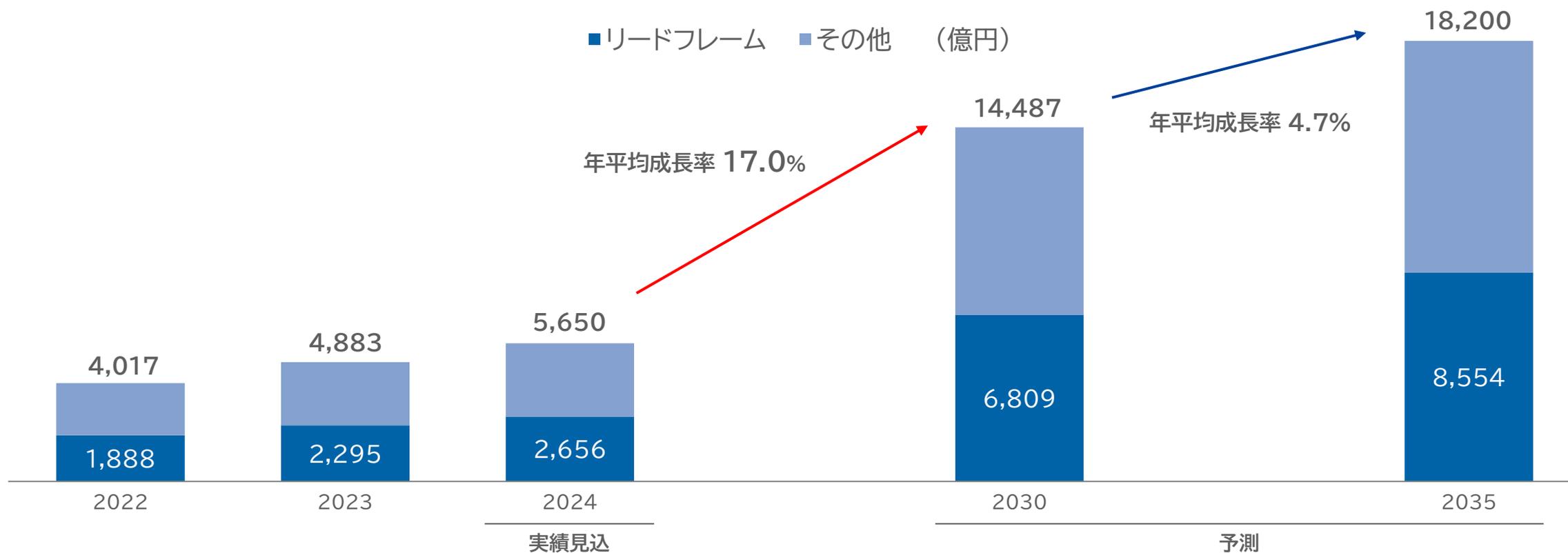
■ ディスクリート ■ オプトエレクトロニクス



出所: WSTS「世界半導体市場統計」

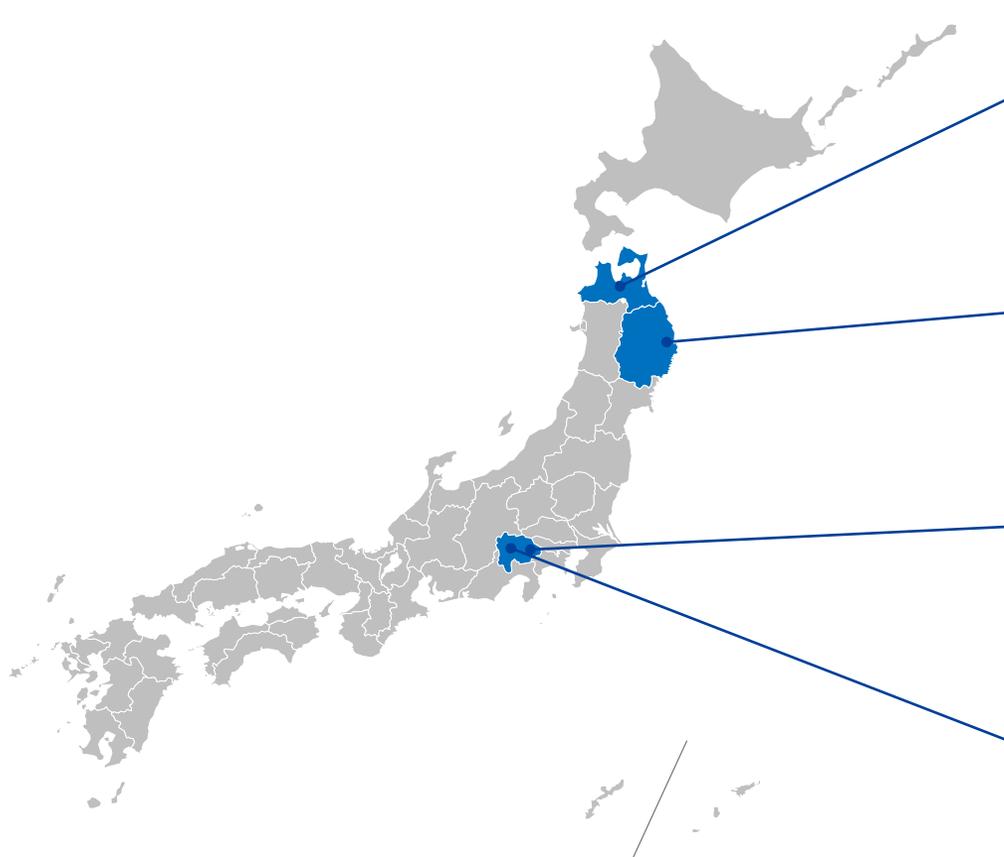
- リードフレームを含むパワーデバイス構成部材\*は2035年には1兆8,200億円へ2030年までの年平均成長率は17%
- 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

## パワーデバイス構成部材の市場予測



\* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳  
出所:富士経済「2024年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」

- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、マイクロコネクタの生産能力を増強
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・大電流対応品の生産体制を強化



## 津軽工場

主要生産品目  
スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



## 岩手工場

主要生産品目  
車載向け受動部品  
スマートフォン向けコネクタ



## 本社工場(上野原)

主要生産品目  
オプト用リードフレーム  
リレー部品



## 本社工場(塩山)

主要生産品目  
パワー半導体用リードフレーム  
オプト用リードフレーム

- エノモト中山(中国)では、リードフレームやコネクタ用部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- エノモトフィリピンでは、車載向けのコネクタ用部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

## 中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**  
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**  
主要生産品目 パワー半導体用リードフレーム  
スマートフォン向けコネクタ用部品

## フィリピン



生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**  
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ用部品  
車載向けスイッチ部品  
パワー半導体用リードフレーム

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。